0 範囲 This specificatio この仕様書は一般電 ure range 使用温度範囲 のperating ten 使用温度範囲 験状態 Unless other 試験及び測定 Norm Norm Norm If an ただ Amb Rela Air p Switt スイジ I dimensions 外観、形料 There shall be no defe 性能上有害な欠陥が as 形状、寸法 Refer	n is applied to low curr 電子機器に用いる微小 囲:-40 ~ 90 °C (norm mperature range shall re 囲とはスイッチがON-OI : At Switch level 単品状 Switch on Taping テー wise specified, the atmos は特に規定がない限り mal temperature 常 mal humidity 常 mal air pressure 常 y doubt arise from judg CU、判定に疑義を生じれ bient temperature 温 tive humidity 相 pressure 気 tuch shall be mounted on ッチは回路基板から浮; 状、寸法 ects that affect the servio	製品仕様 rent circuit TA 、電流回路用の nal humidity, n efer to the rang DFF機能を維持 状態 ーピング状態 iospheric condi の以下の標準均 常温:(Tempera 常湿:(Relative 常圧:(Air pres gement, tests sl た場合は以下 温度:20±2℃ 目対湿度:60~ 気圧:86~106 n PWB without かないように耳 iceability of the ngs. 製品図に	書 (参考) CT Switch <sup>™</sup> used Dタクトスイッチ®に ormal air pressure where this switcle at a c 90 ℃ (no -20 ~ 50 ℃ (Ro tions for making m 大態のもとで行う。 at ure 温度 5~35 <sup>o</sup> humidity 湿度 2: sure 気圧 86~10 hall be conducted a の基準状態で行う -70% kPa t any indication of a なり付ける。 e product.	for general electronic ec ついて適用する。 常湿・常圧) h keeps electrical functio る。 ormal humidity, normal a elative humidity 湿度:: heasurements and tests a ℃) 5~85%) D6kPa) at the following conditio	on within such temperatures. air pressure 常湿·常圧) 20 ~ 85% ) are as follows.
0 範囲 This specificatio この仕様書は一般電 ure range 使用温度範囲 のperating ten 使用温度範囲 験状態 Unless other 試験及び測定 Norm Norm Norm If an ただ Amb Rela Air p Switt スイッ I dimensions 外観、形料 There shall be no defe 性能上有害な欠陥が as 形状、寸法 Refer	朝 on is applied to low curr 電子機器に用いる微小 囲:-40 ~ 90 °C (norm mperature range shall re 囲とはスイッチがON-OI : At Switch level 単品れ Switch on Taping テー wise specified, the atmos は特に規定がない限り mal temperature 常 mal humidity 常 mal air pressure 常 ny doubt arise from judg CU、判定に疑義を生じ7 bient temperature 温 tive humidity 相 pressure 気 the shall be mounted on ッチは回路基板から浮 状、寸法 ects that affect the servio ぶあってはならない。 ・ to the assembly drawin	製品仕様 rent circuit TA 、電流回路用の nal humidity, n efer to the rang DFF機能を維持 状態 ーピング状態 iospheric condi の以下の標準均 常温:(Tempera 常湿:(Relative 常圧:(Air pres gement, tests sl た場合は以下 温度:20±2℃ 目対湿度:60~ 気圧:86~106 n PWB without かないように耳 iceability of the ngs. 製品図に	書 (参考) CT Switch <sup>™</sup> used Dタクトスイッチ®に ormal air pressure where this switcle at a c 90 ℃ (no -20 ~ 50 ℃ (Ro tions for making m 大態のもとで行う。 at ure 温度 5~35 <sup>o</sup> humidity 湿度 2: sure 気圧 86~10 hall be conducted a の基準状態で行う -70% kPa t any indication of a なり付ける。 e product.	for general electronic ec ついて適用する。 常湿・常圧) h keeps electrical functio る。 ormal humidity, normal a elative humidity 湿度:: heasurements and tests a ℃) 5~85%) D6kPa) at the following conditio	May. 202 quipment. on within such temperatures. air pressure 常湿・常圧) 20 ~ 85% ) ure as follows.
<ul> <li>              も囲 This specificatio この仕様書は一般電 のperating ten 使用温度範囲      </li> <li>             trange 保存温度範囲         </li> <li>             why 能 Unless otherwist 就験及び測定                  Norming                  Norming                  Norming                  Norming                  Norming                  Refer      </li> <li>             timensions 外観、形料             There shall be no defee                 性能上有害な欠陥が                  ns                  形状、寸法 Refer      </li> </ul>	電子機器に用いる微小 囲:-40 ~ 90 °C (norm mperature range shall re 囲とはスイッチがON-OI : At Switch level 単品状 Switch on Taping テー wise specified, the atmo には特に規定がない限り mal temperature 常 mal humidity 常 mal air pressure 常 ny doubt arise from judg でし、判定に疑義を生じ行 bient temperature 温 tive humidity 相 pressure 気 the shall be mounted on ッチは回路基板から浮; 状、寸法 ects that affect the servio ぶあってはならない。 ・ to the assembly drawin	、電流回路用の nal humidity, n efer to the rang DFF機能を維持 状態 ーピング状態 ospheric condi の以下の標準判 常温:(Tempera 常湿:(Relative 常圧:(Air pres gement, tests sl た場合は以下 温度:20±2℃ 目対湿度:60~ 気圧:86~106 n PWB without かないように耳 iceability of the ngs.製品図に	Dタクトスイッチ®に ormal air pressure te where this switch っする温度範囲とす -40 ~ 90 °C (no -20 ~ 50 °C (Ro tions for making m 状態のもとで行う。 ature 温度 5~35 humidity 湿度 2: sure 気圧 86~10 hall be conducted a の基準状態で行う ~70% kPa t any indication of a 文り付ける。	ボロいて適用する。 常湿・常圧) h keeps electrical function る。 ormal humidity, normal a elative humidity 湿度:: heasurements and tests a ℃) 5~85%) D6kPa) at the following condition	on within such temperatures. air pressure 常湿·常圧) 20 ~ 85% ) are as follows.
この仕様書は一般 are range 使用温度範囲 のperating tem 使用温度範囲 等 range 保存温度範囲 験状態 Unless other 試験及び測定 Norm Norm If an ただ Amb Rela Air p Switt スイッ I dimensions 外観、形料 There shall be no defee 性能上有害な欠陥が as 形状、寸法 Refer	電子機器に用いる微小 囲:-40 ~ 90 °C (norm mperature range shall re 囲とはスイッチがON-OI : At Switch level 単品状 Switch on Taping テー wise specified, the atmo には特に規定がない限り mal temperature 常 mal humidity 常 mal air pressure 常 ny doubt arise from judg でし、判定に疑義を生じ行 bient temperature 温 tive humidity 相 pressure 気 the shall be mounted on ッチは回路基板から浮; 状、寸法 ects that affect the servio ぶあってはならない。 ・ to the assembly drawin	、電流回路用の nal humidity, n efer to the rang DFF機能を維持 状態 ーピング状態 ospheric condi の以下の標準判 常温:(Tempera 常湿:(Relative 常圧:(Air pres gement, tests sl た場合は以下 温度:20±2℃ 目対湿度:60~ 気圧:86~106 n PWB without かないように耳 iceability of the ngs.製品図に	Dタクトスイッチ®に ormal air pressure te where this switch っする温度範囲とす -40 ~ 90 °C (no -20 ~ 50 °C (Ro tions for making m 状態のもとで行う。 ature 温度 5~35 humidity 湿度 2: sure 気圧 86~10 hall be conducted a の基準状態で行う ~70% kPa t any indication of a 文り付ける。	ボロいて適用する。 常湿・常圧) h keeps electrical function る。 ormal humidity, normal a elative humidity 湿度:: heasurements and tests a ℃) 5~85%) D6kPa) at the following condition	on within such temperatures. air pressure 常湿·常圧) 20 ~ 85% ) are as follows.
Operating ten 使用温度範囲 東ange 保存温度範囲 験状態 Unless other 試験及び測定 Norm Norm If an ただ Amb Rela Air p Switt スイン I dimensions 外観、形料 There shall be no defe 性能上有害な欠陥が as 形状、寸法 Refer	mperature range shall re 囲とはスイッチがON-OI : At Switch level 単品れ Switch on Taping テー wise specified, the atmos は特に規定がない限り mal temperature 常 mal humidity 常 mal air pressure 常 y doubt arise from judg CU、判定に疑義を生じ7 bient temperature 温 tive humidity 相 pressure 気 tch shall be mounted on ッチは回路基板から浮; 状、寸法 ects that affect the servior ぶあってはならない。 ・ to the assembly drawin	efer to the rang DFF機能を維持 状態 ーピング状態 iospheric condi )以下の標準均 常温: (Tempera 常温: (Relative 常圧: (Air pres gement, tests sl た場合は以下 温度: 20±2℃ 目対湿度: 60~ 気圧: 86~106 n PWB without :かないように耳 iceability of the ngs. 製品図に	te where this switcl する温度範囲とす $-40 \sim 90 \ C$ (no $-20 \sim 50 \ C$ (Ro tions for making m 大態のもとで行う。 ature 温度 5~35 <sup>5</sup> humidity 湿度 2: sure 気圧 86~10 hall be conducted a の基準状態で行う -70% kPa t any indication of a 文切付ける。 e product.	h keeps electrical functio $\neg 5_{\circ}$ rmal humidity, normal a elative humidity 湿度: heasurements and tests a $^{\circ}$ C) $5 \sim 85\%$ ) D6kPa) at the following conditio	air pressure 常湿·常圧) 20 ~ 85% ) are as follows.
験状態 Unless other 試験及び測定 Norm Norm If an ただ Amb Rela Air p Switt スイン I dimensions 外観、形料 There shall be no defee 性能上有害な欠陥が as 形状、寸法 Refer	Switch on Taping デー wise specified, the atmo- は特に規定がない限り mal temperature 常 mal humidity 常 mal air pressure 常 ny doubt arise from judg し、判定に疑義を生じれ bient temperature 温 utive humidity 相 pressure 気 the shall be mounted on ッチは回路基板から浮; 状、寸法 ects that affect the servio ぶあってはならない。 to the assembly drawin	-ピング状態 iospheric condi )以下の標準均 常温: (Tempera 常湿: (Relative 常圧: (Air pres- gement, tests sl た場合は以下 温度: 20±2℃ 目対湿度: 60~ 気圧: 86~106 n PWB without :かないように耳 iceability of the ngs. 製品図に	$-20 \sim 50 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	elative humidity 湿度: neasurements and tests a ℃) 5~85%) 06kPa) at the following conditio	$20 \sim 85\%$ ) are as follows.
試験及び測定 Norm Norm Norm If an ただ Amb Rela Air p Swite スイ: I dimensions 外観、形料 There shall be no defee 性能上有害な欠陥が as 形状、寸法 Refer	は特に規定がない限り mal temperature 常 mal humidity 常 mal air pressure 常 ny doubt arise from judg し、判定に疑義を生じ7 pient temperature 温 tive humidity 相 pressure 気 tch shall be mounted on ッチは回路基板から浮; 状、寸法 ects that affect the servio があってはならない。 to the assembly drawin	D以下の標準制 常温: (Tempera 常湿: (Relative 常圧: (Air press gement, tests sh た場合は以下 温度: 20±2℃ 目対湿度: 60~ 気圧: 86~106 n PWB without かないように耳 iceability of the ngs. 製品図に	大態のもとで行う。 ature 温度 5~35 humidity 湿度 2: sure 気圧 86~10 hall be conducted a の基準状態で行う ~70% kPa t any indication of a t any indication of a t any indication of a	°C) 5~85%) 06kPa) at the following conditio	
Norm Norm Norm If an ただ Amb Rela Air p Switt スイン I dimensions 外観、形料 There shall be no defe 性能上有害な欠陥が as 形状、寸法 Refer	mal temperature 常 mal humidity 常 mal air pressure 常 ny doubt arise from judg ひ、判定に疑義を生じ7 pient temperature 温 ntive humidity 相 pressure 気 tch shall be mounted on ッチは回路基板から浮 状、寸法 ects that affect the servio ぶあってはならない。 ・ to the assembly drawin	常温: (Tempera 常温: (Relative 常圧: (Air pres gement, tests sl た場合は以下 温度: 20±2℃ 目対湿度: 60~ 気圧: 86~106 n PWB without かないように耳 iceability of the ngs. 製品図に	ature 温度 5~35 <sup>6</sup> humidity 湿度 22 sure 気圧 86~10 hall be conducted a の基準状態で行う ~70% kPa t any indication of なり付ける。 e product.	5~85%) )6kPa) at the following conditio	ns.
Norm Norm If an ただ Amb Rela Air p Switt スイン I dimensions 外観、形料 There shall be no defee 性能上有害な欠陥が ns 形状、寸法 Refer	mal humidity 常 mal air pressure 常 ny doubt arise from judg に、判定に疑義を生じた bient temperature 温 titve humidity 相 pressure 気 tch shall be mounted on ッチは回路基板から浮; 状、寸法 ects that affect the servio ぶってはならない。 to the assembly drawin	常湿: (Relative 常圧: (Air pres. gement, tests sl た場合は以下 温度: 20±2℃ 目対湿度: 60~ 気圧: 86~106 n PWB without かないように耳 iceability of the ngs. 製品図に	humidity 湿度 2: sure 気圧 86~10 hall be conducted a の基準状態で行う ~70% kPa t any indication of i 対り付ける。 e product.	5~85%) )6kPa) at the following conditio	ns.
Norm If an ただ Amb Rela Air p Swite スイシ I dimensions 外観、形料 There shall be no defe 性能上有害な欠陥が as 形状、寸法 Refer	mal air pressure 常 ay doubt arise from judg し、判定に疑義を生じ7 pient temperature 温 tive humidity 相 pressure 気 tch shall be mounted on ッチは回路基板から浮; 状、寸法 ects that affect the servior ぶあってはならない。 to the assembly drawin	常圧: (Air press gement, tests sl た場合は以下 温度: 20±2℃ 目対湿度: 60~ 気圧: 86~106 n PWB without かないように耳 iceability of the ngs. 製品図に	sure 気圧 86~10 hall be conducted a の基準状態で行う ~70% kPa t any indication of t なり付ける。 e product.	96kPa) at the following conditio	ns.
If an ただ Amb Rela Air p Swit スイ: I dimensions 外観、形料 There shall be no defe 性能上有害な欠陥が as 形状、寸法 Refer	y doubt arise from judg に、判定に疑義を生じた pient temperature 温 tive humidity 相 pressure 気 tch shall be mounted on ッチは回路基板から浮れ 状、寸法 ects that affect the servion ぶあってはならない。 to the assembly drawin	gement, tests sl た場合は以下 温度: 20±2℃ 目対湿度: 60~ 気圧: 86~1060 n PWB without iceability of the ngs. 製品図に	hall be conducted a の基準状態で行う ~70% kPa t any indication of なり付ける。 e product.	at the following conditio	uns.
ただ Amb Rela Air p Swit スイッ I dimensions 外観、形料 There shall be no defe 性能上有害な欠陥が ns 形状、寸法 Refer	に、判定に疑義を生じ bient temperature 温 titve humidity 相 pressure 気 tch shall be mounted on ッチは回路基板から浮 状、寸法 ects that affect the servio あってはならない。 to the assembly drawin	た場合は以下 記度: 20±2℃ 目対湿度: 60~ 気圧: 86~106 n PWB without かないように耳 iceability of the ngs. 製品図に	の基準状態で行う ~70% kPa t any indication of 取り付ける。 e product.	0.	ns.
Amb Rela Air p Swit スイ: I dimensions 外観、形 There shall be no defe 性能上有害な欠陥が as 形状、寸法 Refer	bient temperature 温 tive humidity 相 pressure 気 tch shall be mounted on ッチは回路基板から浮; 状、寸法 ects that affect the servior ぶあってはならない。 to the assembly drawin	温度: 20±2℃ 目対湿度: 60~ 気圧: 86~106 n PWB without かないように耳 iceability of the ngs. 製品図に	~70% kPa t any indication of なり付ける。 e product.		
Rela Air p Swit スイシ dimensions 外観、形料 There shall be no defe 性能上有害な欠陥が ns 形状、寸法 Refer	tive humidity 相 pressure 気 tch shall be mounted on ッチは回路基板から浮 状、寸法 ects that affect the servio ぶあってはならない。 to the assembly drawin	目対湿度: 60〜 気圧: 86〜106 n PWB without かないように耳 iceability of the ngs. 製品図に	kPa t any indication of 対けける。 e product.	switch floating.	
Air p Switt スイン d dimensions 外観、形料 There shall be no defe 性能上有害な欠陥が as 形状、寸法 Refer	pressure 気 tch shall be mounted on ッチは回路基板から浮; 状、寸法 ects that affect the servio ぶあってはならない。 to the assembly drawin	気圧: 86~106 n PWB without かないように耳 iceability of the ngs. 製品図に	kPa t any indication of 対けける。 e product.	switch floating.	
Switt スイシ dimensions 外観、形料 There shall be no defe 性能上有害な欠陥が ns 形状、寸法 Refer	tch shall be mounted on ッチは回路基板から浮 状、寸法 ects that affect the servio あってはならない。 to the assembly drawin	n PWB without かないように耳 iceability of the ngs. 製品図に	t any indication of 対けける。 e product.	switch floating.	
スイッ dimensions 外観、形料 There shall be no defe 性能上有害な欠陥が ns 形状、寸法 Refer	ッチは回路基板から浮 状、寸法 ects that affect the servio ぶあってはならない。 to the assembly drawin	かないように耳 iceability of the ngs. 製品図に	えり付ける。 e product.	switch floating.	
l dimensions 外観、形 There shall be no defe 性能上有害な欠陥が ns 形状、寸法 Refer	状、寸法 ects that affect the servio がってはならない。 <sup>-</sup> to the assembly drawin	iceability of the ngs. 製品図に	e product.		
There shall be no defe 性能上有害な欠陥が ns 形状、寸法 Refer	ects that affect the servio ぶあってはならない。 to the assembly drawin	ngs. 製品図に			
回路形式 <u>1</u> poles <u>1</u>		接点	sembly drawings	回路の詳細は製品図	による)
X		0	, ,		,
ratings 絶対最大定格	4 <u>12</u> V DC <u>50</u> mA	(Resistive load	1)(抵抗負荷)		
最小定格	<u>1</u> V DC <u>10</u> $\mu$ A (I				
n 電気的性能					
〔目			試験条件		Criteria 判定基準
shall be made スイッチ操作 (1) Depressio	e. 部中央に下記の静荷重 on 押圧力 : <u>3.2</u> N g method 測定方法 : 1 meter 1kHz	重を加えて測算 1 kHz small-cu r or voltage dro z微少電流接触	定する。 nrrent contact resist op method at 5VD( 地抵抗計、	tance	<u>500 mΩ Max.</u>
	i目 Applying a b shall be mad スイッチ操作 (1) Depressio	<ul> <li>I目 Test contained</li> <li>Applying a below static load to the shall be made.</li> <li>スイッチ操作部中央に下記の静荷</li> <li>(1) Depression 押圧力: <u>3.2</u> N</li> <li>(2) Measuring method 測定方法:</li> <li>mete</li> <li>1kHz</li> </ul>	<ul> <li>IEI Test conditions</li> <li>Applying a below static load to the center of the st shall be made.</li> <li>スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加えて測算</li> <li>(1) Depression 押圧力: <u>3.2</u> N</li> <li>(2) Measuring method 測定方法: 1 kHz small-cu meter or voltage dro 1kHz微少電流接触</li> </ul>	正目         Test conditions         試験条件           Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made.         スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加えて測定する。           (1) Depression 押圧力:         3.2 N           (2) Measuring method 測定方法:         1 kHz small-current contact resist	百日     Test conditions     試験条件       Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made.     スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加えて測定する。       スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加えて測定する。     (1) Depression 押圧力: 3.2 N       (2) Measuring method 測定方法: 1 kHz small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA.       1kHz微少電流接触抵抗計、

3 X IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Items 項目 insulation resistance 絶縁抵抗 Voltage proof 耐電圧	Undt様書(参考)         Test conditions       試験条件         Measurements shall be made following the test set forth below:       下記条件で試験を行った後、測定する。         (1) Test voltage       印加電圧: 100 V DC for 1 min.         (2) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame)       端子間、金属フレームがある場合は、端子と         磁属フレーム間       Measurements shall be made following the test set forth below:         下記条件で試験を行った後、測定する。       (1)Test voltage 印加電圧: 100 V AC (50~60Hz)         (2)Duration 印加時間: 1 min       (3)Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame)         端子間、金属フレームがある場合は、端子と       金属フレームがある場合は、端子と         成員フレームがある場合は、端子と       金属フレームがある場合は、端子と         (3)Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame)         端子間、金属フレームがある場合は、端子と       金属フレーム間	Criteria 判定基準 <u>100</u> MΩ Min. There shall be no breakdown. 絶縁破壊のないこと。
rr ∦ ∦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Insulation resistance 絶縁抵抗 Voltage proof 耐電圧	Measurements shall be made following the test set forth below:         下記条件で試験を行った後、測定する。         (1) Test voltage       印加電圧: 100 V DC for 1 min.         (2) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間         Measurements shall be made following the test set forth below:         下記条件で試験を行った後、測定する。         (1)Test voltage 印加電圧: 100 V AC (50~60Hz)         (2)Duration 印加時間: 1 min         (3)Applied position印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間	<u>100</u> MΩ Min. There shall be no breakdown.
.3 X .3 X .4 E	resistance 絶縁抵抗 Voltage proof 耐電圧	<ul> <li>下記条件で試験を行った後、測定する。</li> <li>(1) Test voltage 印加電圧: <u>100</u> V DC for 1 min.</li> <li>(2) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間</li> <li>Measurements shall be made following the test set forth below:</li> <li>下記条件で試験を行った後、測定する。</li> <li>(1)Test voltage 印加電圧: <u>100</u> V AC (50~60Hz)</li> <li>(2)Duration 印加時間: 1 min</li> <li>(3)Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間</li> </ul>	There shall be no breakdown.
я́л 3 № П П 4 ЕЕ	絶縁抵抗 Voltage proof 耐電圧	<ul> <li>(1) Test voltage 印加電圧: <u>100</u> V DC for 1 min.</li> <li>(2) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間</li> <li>Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。</li> <li>(1) Test voltage 印加電圧: <u>100</u> V AC (50~60Hz)</li> <li>(2) Duration 印加時間: 1 min</li> <li>(3) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間</li> </ul>	
.3 X ₫ 4 E	Voltage proof 耐電圧	<ul> <li>(2) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間</li> <li>Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。</li> <li>(1)Test voltage 印加電圧: 100 V AC (50~60Hz)</li> <li>(2)Duration 印加時間:1 min</li> <li>(3)Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間</li> </ul>	
₫ .4 E	耐電圧	frame,between terminals and ground(frame)         端子間、金属フレームがある場合は、端子と         金属フレーム間         Measurements shall be made following the test set forth below:         下記条件で試験を行った後、測定する。         (1)Test voltage 印加電圧: 100 V AC (50~60Hz)         (2)Duration 印加時間:1 min         (3)Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame,between terminals and ground (frame)         端子間、金属フレームがある場合は、端子と         金属フレーム間	
₫ .4 E	耐電圧	端子間、金属フレームがある場合は、端子と 金属フレーム間 Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Test voltage 印加電圧: <u>100</u> V AC (50~60Hz) (2)Duration 印加時間: 1 min (3)Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame,between terminals and ground (frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と 金属フレーム間	
₫ .4 E	耐電圧	金属フレーム間         Measurements shall be made following the test set forth below:         下記条件で試験を行った後、測定する。         (1)Test voltage 印加電圧:         100 V AC (50~60Hz)         (2)Duration 印加時間:         1 min         (3)Applied position 印加場所:         Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame)         端子間、金属フレームがある場合は、端子と         金属フレーム間	
₫ .4 E	耐電圧	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Test voltage 印加電圧: <u>100</u> V AC (50~60Hz) (2)Duration 印加時間:1 min (3)Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame,between terminals and ground (frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と 金属フレーム間	
₫ .4 E	耐電圧	<ul> <li>下記条件で試験を行った後、測定する。</li> <li>(1)Test voltage 印加電圧: <u>100</u> V AC (50~60Hz)</li> <li>(2)Duration 印加時間: 1 min</li> <li>(3)Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame,between terminals and ground (frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と 金属フレーム間</li> </ul>	
.4 E		<ul> <li>(1)Test voltage 印加電圧: <u>100</u> V AC (50~60Hz)</li> <li>(2)Duration 印加時間: 1 min</li> <li>(3)Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と 金属フレーム間</li> </ul>	
	Bounce	<ul> <li>(2)Duration 印加時間:1 min</li> <li>(3)Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間</li> </ul>	
	Bounce	<ul> <li>(3)Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間</li> </ul>	
	Bounce	frame, between terminals and ground (frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と 金属フレーム間	
	Bounce	端子間、金属フレームがある場合は、端子と 金属フレーム間	
	Bounce		
	Bounce		
)		Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use	ON bounce : <u>10 ms</u> Max.
	バウンス	(3 to 4 operations per s )bounce shall be tested at "ON" and "OFF".	OFF bounce : <u>10 ms Max.</u>
		スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し、	
		ON時及びOFF時のバウンスを測定する。	
		<u>_</u>	
		Switch	
	· · · · · ·	1+2 AL 111, Ar	
lecha	nical specification 機 Items 項目	他的性能 Test conditions 試驗条件	Criteria 判定基準
.1 (	Operating force	Place the switch such that the direction of switch operation is vertical. Then, apply the	<u> 1.6 ± 0.5 N</u>
ŕ	作動力	the below force to the center of the switch operation. Measure the maximum force	
		that the switch makes "ON". 3 times push shall be done before the measurement.	
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチ操作部中央に下記	
		の荷重を加える。作動力は、スイッチがONするまでの最大荷重を測定する。	
		測定前に3回予備押しを行うこと。	
		(1) Test force 押圧力 : <u>2.1 N</u>	
		(2) Measurement speed 測定速度: 0.5 mm/s	
.2 T	Fravel	Place the switch such that the direction of switch operation is vertical. Then, apply the	0.23 ± 0.15 mm
1	移動量	below force to the center of the switch operation. Measure the travel distance that the	
		switch makes "ON". 3 times push shall be done before the measurement.	
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチ操作部中央に下記	
		の荷重を加える。移動量は、スイッチがONするまでの距離を測定する。	
		測定前に3回予備押しを行うこと。	
		(1) Test force 押圧力 : <u>2.1</u> N	
		(2) Measurement speed 測定速度: <u>0.5</u> mm/s	

DOCUMENT No.	TITLE	PAGE
KSN-736	PRODUCT SPECIFICATIONS (For reference)	3/14
	製品仕様書(参考)	
Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
7.3 Return force 復帰力	<ul> <li>Place the switch such that the direction of switch operation is vertical. Then, apply the below force to the center of the switch operation, Measure the force that the center of the switch operation returns to the initial position. 3 times push shall be done before the measurement.</li> <li>スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチ操作部中央に下記の荷重を加える。復帰力は、荷重を除するときにスイッチ操作部中央が復帰する力を測定する。測定前に3回予備押しを行うこと。</li> <li>(1) Test force 押圧力 : <u>2.1</u>N</li> <li>(2) Measurement speed 測定速度: <u>0.5 mm/s</u></li> </ul>	<u>0.1</u> N Min.
7.4 Stop strength ストッパー強度	Place the switch such that the direction of switch operation is vertical. Then, apply the below static load to the direction of stem operation. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ 以下の静荷重を加える。 (1) Depression 押圧力: <u>30</u> N (2) Time 時間: <u>15</u> s	Keep electrical ON/OFF. 電気的にON-OFFすること。 Item 6.1
8. Environmental specification 而		
Items 項目 Test condition 8.1 Resistance to low	ns 試験条件 Cri Undertake the below test conditions. The measurement is done after the	iteria 判定基準 Item 6
temperatures 耐寒性	endertake the below test conditions. The measurement is done after the test sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 hour. 次の試験後、常温常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>-40±2</u> ℃ (2) Time 時間: <u>96</u> h (3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Nem o Operating force 作動力(Item 7.1) : <u>+20</u> % of initial force 初期規格値に対して Travel 移動量(Item 7.2): <u>+20</u> % of initial travel 初期規格値に対して
8.2 Heat resistance 耐熱性	Undertake the below test conditions. The measurement is done after the test sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 hour. 次の試験後、常温常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>90 ± 2</u> ℃ (2) Time 時間: <u>96</u> h	Item 6 Operating force 作動力(Item 7.1) : $\pm 20$ % of initial force 初期規格値に対して Travel 移動量(Item 7.2): $\pm 20$ % of initial travel 初期規格値に対して
8.3 Moisture resistance 耐湿性	Undertake the below test conditions. The measurement is done after the test sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 hour. 次の試験後、常温常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>60</u> ±2 ℃ (2) Time 時間: <u>96</u> h (3) Relative humidity 相対湿度: <u>90</u> ~ <u>95</u> % (4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1): <u>1</u> $\Omega$ Max. Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 6.2): <u>10</u> M $\Omega$ Min. Item 6.3 Item 6.4 Operating force 作動力(Item 7.1): <u>±20</u> % of initial force 初期規格値に対して Travel 移動量(Item 7.2): <u>±20</u> % of initial travel 初期規格値に対して

KSN-736 Items 項目	PRODUCT SPECIFICATIONS (For reference)           製品仕様書 (参考)	4/14
	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
8.4 Change of temperature 温度サイクル	After exposed to the below test cycles, the measurement is done after the test sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 hour. Water drops shall be removed. 下記条件で以下回数のサイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定 する。ただし、水滴は取り除く。 A A = $\pm 90 ^{\circ}$ C B = $\pm 40 ^{\circ}$ C C = $2h$ D = $1h$ E = $2h$ F = $1h$ (1)Number of cycles $ + d\rho \nu $ $\pm 5$ cycles	Item 6 Operating force 作動力(Item 7.1) : <u>±20</u> % of initial force 初期規格値に対して Travel 移動量(Item 7.2): <u>±20</u> % of initial travel 初期規格値に対して
8.5 Resistance to Soldering heat はんだ耐熱性	Mount the switch on the test PWB (130mm×35mm x1.2mm,Material: CEM3) and let the samples go through a reflow process two times. The reflow condition refers to Item 10.2. Switch is stabilized with normal temperature before going through the 2 <sup>nd</sup> reflow process. The measurement should be taken after the switch is stabilized with normal temperature and humidity for 1 hours. スイッチを試験基板(130mm×35mm t=0.9mm 材質CEM3)に実装し 10.2項のリフローはんだ条件で2回炉を通過させる。(2回目は基板温度が 常温に下がってから投入する。) 常温常湿で1時間放置後に測定する。	Item 6.1 to 6.3 Operating force 作動力(Item 7.1) : <u>±20</u> % of initial force 初期規格値に対して Travel 移動量(Item 7.2): <u>±20</u> % of initial travel 初期規格値に対して Item 7.3

KSN-736	PRODUCT SPECIFICATIONS (For reference	e) 5/14
	製品仕様書(参考)	
Endurance specification ∦	讨久性能	
Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
9.1 Operating life 動作寿命	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) <u>5</u> VDC <u>5</u> mA resistive load 抵抗負荷 (2) Rate of operation 動作速度: <u>2</u> to <u>3</u> operations per s 回/秒 (3) Depression 押圧力: <u>2.1</u> N (4)Cycles of operation 動作回数: <u>1.000,000</u> cycles 回	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1): <u>20</u> $\Omega$ Max. Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 6.2): <u>10</u> M $\Omega$ Min. Operating force 作動力(Item 7.1): <u>±30</u> % of initial force 初期規格値に対して Travel 移動量(Item 7.2): <u>-30</u> ~ <u>+50</u> % of initial travel 初期規格値に対して Item 6.3 Item 6.4
9.2 Vibration resistance 耐振性	Measurements shall be made following the test set forth below:         下記条件で試験を行った後、測定する。         (1)Vibration frequency range 振動数範囲: <u>10 ~ 55</u> Hz         (2)Total amplitude       全振幅: <u>1.5</u> mm         (3)Sweep ratio       掃引の割合: <u>10 - 55 - 10</u> Hz Approx.         1 min 約 1 分         (4)Method of changing sweep vibration frequency : Logarithmic or uniform         掃引振動数の変化方法       対数又は一様掃引         (5)Direction of vibration : Three mutually perpendicular directions,         振動の方向       including the direction of the travel         スイッチ操作方向を中心とした垂直3方向         (6)Duration 振動時間: 2 h each ( 6 h in total) 各 2時間 (計 6時間)	Item 6.1 Operating force 作動力(Item 7.1) : <u>+20</u> % of initial force 初期規格値に対して Travel 移動量(Item 7.2): <u>+20</u> % of initial travel 初期規格値に対して
9.3 Shock 耐衝擊性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Acceleration 加速度: <u>784</u> m/s <sup>2</sup> (2)Acting time 作用時間: <u>11</u> msec (3)Test direction 試験方向: <u>6</u> directions 6 面 (4)Number of shocks 試験回数: <u>3</u> times per direction ( <u>18</u> times in total) 各方向各 <u>3</u> 回(計 <u>18</u> 回)	Item 6.1 Operating force 作動力(Item 7.1) : <u>±20</u> % of initial force 初期規格値に対して Travel 移動量(Item 7.2): <u>±20</u> % of initial travel 初期規格値に対して

	UMENT No.	TITLE	PAGE
	KSN-736	PRODUCT SPECIFICATIONS (For reference)	6/14
		製品仕様書(参考)	
). Sold	ering conditions 半田 Items 項目	l付条件 Recommended conditions 推奨条件	
10.1	Hand soldering	Please practice according to below conditions.	
	手半田	以下の条件にて実施して下さい。	
		(1) Soldering temperature 半田温度: <u>350</u> ℃ Max.	
		(2) Continuous soldering time 連続半田時間: <u>3</u> s Max.	
		(3) Capacity of soldering iron 半田コテ容量: 20 W Max.	
		(4) Excessive force shall not be applied to the terminals.	
		端子に異常加圧のないこと。	
		(5) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its topside of switch. スイッチの上面からフラックスが浸入しない様にして下さい。	
0.2	Reflow soldering	Please practice according to below conditions.	
	リフロー半田	以下の条件にて実施して下さい。	
		(1)Profile 温度プロファイル	
		• Depending on reflow chamber used, the actual reflow condition might be slightly different.	
		This may have a possibility to affect product.Please well-check the suitability with your reflow cham リフロー槽の種類により、多少条件が異なるため製品に影響を及ぼす可能性があります。事前に十	
		ファロー 伯の理想により、多久木口が発気のにの表面に必要で及ばす 小昭匡がのりよう。 ず前に 1	
		Surface of product Temperature	
		部品表面温度(℃)	
		260 °C Max.	<u>3</u> s Max. iture ピーク温度
			uure L り 価度
		150	
			ne 時間
		$ $ $\underline{120 \text{ s Max}}$ $ $ $ $ $\underline{40 \text{ s Max.}}$ $ $	
		(Pre-heating 予熱)	
		<u>3~4</u> min. Max.	
		Time inside soldering equipment 炉内通過時間	
		(2)Thickness of printed circuit board shall be <u>0.9</u> mm.	
		基板厚さは <u>0.9</u> mmを推奨いたします。	
		(3)Allowable soldering time 半田回数: 2 times Max.	
		(The temperature shall go down to a normal temperature in prior to exposure to the second time :	
		2回目を行う場合には、スイッチが常温に戻ってから行うこと。)	

KSN-736PRODUCT SPECIFICATIONS (For reference)7/14製品仕様書 (参考)1tems 項目Recommended conditions 推奨条件	DOCUMENT No.	TITLE	PAGE
Items 項目         Recommended conditions         推奨条件           0.3         Other precautions         (1) Switch terminals and PWB top face shall be free from flux in prior to soldering. For soldering         # Fint CX / 2 + 50 端子及びブリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。         (2) Not washing switch with solvent or like, after soldering process.         # EH付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないでください。         (3) Recommended cream paste: M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム= 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨会社         (4) When chip components are soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering after reflow soldering.         (5) Reflow the stress, etc to switch may vary depending on reflow soldering chambers. Please verify it with the actual samples beforehand.         リフロー 槽の種類により、スイッチャーのリフロー熱等,影響が異なる可能性がありますので、事前に十分確認の上 使用してください。         (6) The click feeling may be degraded af			7/14
Items 項目         Recommended conditions         推奨条件           0.3         Other precautions         (1) Switch terminals and PWB top face shall be free from flux in prior to soldering. For soldering         # Fint CX / 2 + 50 端子及びブリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。         (2) Not washing switch with solvent or like, after soldering process.         # EH付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないでください。         (3) Recommended cream paste: M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム= 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V (SENU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.         # 推奨会社         (4) When chip components are soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering after reflow soldering.         (5) Reflow the stress, etc to switch may vary depending on reflow soldering chambers. Please verify it with the actual samples beforehand.         リフロー 槽の種類により、スイッチャーのリフロー熱等,影響が異なる可能性がありますので、事前に十分確認の上 使用してください。         (6) The click feeling may be degraded af		製品仕様書(参考)	
<ul> <li>0.3 Other precautions For soldering</li> <li>* 田付けに関する</li> <li>* 日付けに関する</li> <li>* の他注意事項</li> <li>(1) Switch terminals and PWB top face shall be free from flux in prior to soldering. 事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。</li> <li>(2) Not washing switch with solvent or like, after soldering process. *田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないでください。</li> <li>(3) Recommended cream paste: M705-GRN360-K2V (SENIU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent. 推奨クリーム半田:千住金属工業(林) M705-GRN360-K2V (SENIU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent. 推奨クリーム半田:千住金属工業(林) M705-GRN360-K2V (SENIU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent. #班グリーム半田:千住金属工業(林) M705-GRN360-K2V (SENIU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent.</li> <li>(4) When chip components are soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering after reflow soldering. flux ejection may potentially let flux to penetrate along the plastic housing into the inside of switch. PWB shall not have through-hole underneath and/or near the mounted switch to avoid such flux penetration.</li> <li>本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス 吹き上げ等によりスイッチ(画面からフラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないでください。</li> <li>(5) Reflow heat stress, et to switch may vary depending on reflow soldering chambers. Please verify it with the actual samples beforehand.</li> <li>リフロー槽の種類により、スイッチへのリフロー熱等、影響が異なる可能性がありますので、事前に十分確認の上 使用してください。</li> <li>(6) The click feeling may be degraded after exposed to reflow heat for a long time. Reflow soldering should be performed in the shortest time and the lowest temperature.</li> <li>熟履歴が加わるとクリックルッグ感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願い します。</li> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste : <u>0.08</u> mm</li> </ul>	Items 項		
単田付けに関する その他注意事項(2) Not washing switch with solvent or like, after soldering process. 単田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないでください。(3) Recommended cream paste: M705-GRN360-K2V (SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent. 推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V 同等品(4) When chip components are soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering after reflow soldering, flux ejection may potentially let flux to penetrate along the plastic housing into the inside of switch. PWB shall not have through-hole underneath and/or near the mounted switch to avoid such flux penetration. 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス 吹き上げ等によりスイッチ側面からフラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないでください。(5) Reflow heat stress, etc to switch may vary depending on reflow soldering chambers. Please verify it with the actual samples beforehand. リフロー槽の種類により、スイッチへのリフロー熱等、影響が異なる可能性がありますので、事前に十分確認の上 使用してください。(6) The click feeling may be degraded after exposed to reflow heat for a long time. Reflow soldering should be performed in the shortest time and the lowest temperature. 熟履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願い します。(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。(8) The thickness of solder paste : <u>0.08</u> mm			
<ul> <li>その他注意事項</li> <li>半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないでください。</li> <li>(3) Recommended cream paste: M705-GRN360-K2V (SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD.) or equivalent. 推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V 同等品</li> <li>(4) When chip components are soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering after reflow soldering, flux ejection may potentially let flux to penetrate along the plastic housing into the inside of switch. PWB shall not have through-hole underneath and/or near the mounted switch to avoid such flux penetration.</li> <li>本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップキ田して使用する場合は、ディップ時のフラックス 吹き上げ等によりスイッチ側面からフラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないでください。</li> <li>(5) Reflow heat stress, etc to switch may vary depending on reflow soldering chambers. Please verify it with the actual samples beforehand.</li> <li>リフロー槽の種類により、スイッチへのリフロー熱等、影響が異なる可能性がありますので、事前に十分確認の上 使用してください。</li> <li>(6) The click feeling may be degraded after exposed to reflow heat for a long time. Reflow soldering should be performed in the shortest time and the lowest temperature.</li> <li>熟履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願い します。</li> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste : <u>0.08</u> mm</li> </ul>	For soldering	事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。	
<ul> <li>(3) Recommended cream paste: M705-GRN360-K2V (SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD ) or equivalent. 推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V 同等品</li> <li>(4) When chip components are soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering after reflow soldering, flux ejection may potentially let flux to penetrate along the plastic housing into the inside of switch. PWB shall not have through-hole underneath and/or near the mounted switch to avoid such flux penetration.</li> <li>本スイッチをリフロー半田後、ブリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス 吹き上げ等によりスイッチ側面からフラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないでください。</li> <li>(5) Reflow heat stress, etc to switch may vary depending on reflow soldering chambers. Please verify it with the actual samples beforehand.</li> <li>リフロー槽の種類により、スイッチへのリフロー熱等、影響が異なる可能性がありますので、事前に十分確認の上 使用してください。</li> <li>(6) The click feeling may be degraded after exposed to reflow heat for a long time. Reflow soldering should be performed in the shortest time and the lowest temperature.</li> <li>熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願い します。</li> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste : <u>0.08</u> mm</li> </ul>			
<ul> <li>推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2V 同等品</li> <li>(4) When chip components are soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering after reflow soldering, flux ejection may potentially let flux to penetrate along the plastic housing into the inside of switch. PWB shall not have through-hole underneath and/or near the mounted switch to avoid such flux penetration.</li> <li>本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス 吹き上げ等によりスイッチ側面からフラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないでください。</li> <li>(5) Reflow heat stress, etc to switch may vary depending on reflow soldering chambers. Please verify it with the actual samples beforehand.</li> <li>リフロー槽の種類により、スイッチへのリフロー熱等、影響が異なる可能性がありますので、事前に十分確認の上 使用してください。</li> <li>(6) The click feeling may be degraded after exposed to reflow heat for a long time. Reflow soldering should be performed in the shortest time and the lowest temperature.</li> <li>熟履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願い します。</li> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste: <u>0.08</u> mm</li> </ul>	その他注意事項		
<ul> <li>(4) When chip components are soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering after reflow soldering, flux ejection may potentially let flux to penetrate along the plastic housing into the inside of switch. PWB shall not have through-hole underneath and/or near the mounted switch to avoid such flux penetration.</li> <li>本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス 吹き上げ等によりスイッチ側面からフラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないでください。</li> <li>(5) Reflow heat stress, etc to switch may vary depending on reflow soldering chambers. Please verify it with the actual samples beforehand.</li> <li>リフロー槽の種類により、スイッチへのリフロー熱等、影響が異なる可能性がありますので、事前に十分確認の上 使用してください。</li> <li>(6) The click feeling may be degraded after exposed to reflow heat for a long time. Reflow soldering should be performed in the shortest time and the lowest temperature.</li> <li>熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願い します。</li> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste : <u>0.08</u> mm</li> </ul>		-	quivalent.
<ul> <li>soldering, flux ejection may potentially let flux to penetrate along the plastic housing into the inside of switch. PWB shall not have through-hole underneath and/or near the mounted switch to avoid such flux penetration.</li> <li>本スイッチをリフロー半田後、ブリント基板裏面をディッブ半田して使用する場合は、ディッブ時のフラックス 吹き上げ等によりスイッチ側面からフラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないでください。</li> <li>(5) Reflow heat stress, etc to switch may vary depending on reflow soldering chambers. Please verify it with the actual samples beforehand.</li> <li>リフロー槽の種類により、スイッチへのリフロー熱等、影響が異なる可能性がありますので、事前に十分確認の上 使用してください。</li> <li>(6) The click feeling may be degraded after exposed to reflow heat for a long time. Reflow soldering should be performed in the shortest time and the lowest temperature.</li> <li>熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願い します。.</li> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch.</li> <li>スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste: <u>0.08</u> mm</li> </ul>			flow
<ul> <li>of switch. PWB shall not have through-hole underneath and/or near the mounted switch to avoid such flux penetration.</li> <li>本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス 吹き上げ等によりスイッチ側面からフラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないでください。</li> <li>(5) Reflow heat stress, etc to switch may vary depending on reflow soldering chambers. Please verify it with the actual samples beforehand.</li> <li>リフロー槽の種類により、スイッチへのリフロー熱等、影響が異なる可能性がありますので、事前に十分確認の上 使用してください。</li> <li>(6) The click feeling may be degraded after exposed to reflow heat for a long time. Reflow soldering should be performed in the shortest time and the lowest temperature.</li> <li>熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願い します。</li> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste : <u>0.08</u> mm</li> </ul>			
<ul> <li>本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス 吹き上げ等によりスイッチ側面からフラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないでください。</li> <li>(5) Reflow heat stress, etc to switch may vary depending on reflow soldering chambers. Please verify it with the actual samples beforehand. リフロー槽の種類により、スイッチへのリフロー熱等、影響が異なる可能性がありますので、事前に十分確認の上 使用してください。</li> <li>(6) The click feeling may be degraded after exposed to reflow heat for a long time. Reflow soldering should be performed in the shortest time and the lowest temperature.</li> <li>熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願い します。</li> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste : <u>0.08</u> mm</li> </ul>			
<ul> <li>吹き上げ等によりスイッチ側面からフラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないでください。</li> <li>(5) Reflow heat stress, etc to switch may vary depending on reflow soldering chambers. Please verify it with the actual samples beforehand.</li> <li>リフロー槽の種類により、スイッチへのリフロー熱等、影響が異なる可能性がありますので、事前に十分確認の上使用してください。</li> <li>(6) The click feeling may be degraded after exposed to reflow heat for a long time. Reflow soldering should be performed in the shortest time and the lowest temperature.</li> <li>熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします。</li> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste : <u>0.08</u> mm</li> </ul>		flux penetration.	
<ul> <li>スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないでください。</li> <li>(5) Reflow heat stress, etc to switch may vary depending on reflow soldering chambers. Please verify it with the actual samples beforehand.</li> <li>リフロー槽の種類により、スイッチへのリフロー熱等、影響が異なる可能性がありますので、事前に十分確認の上 使用してください。</li> <li>(6) The click feeling may be degraded after exposed to reflow heat for a long time. Reflow soldering should be performed in the shortest time and the lowest temperature.</li> <li>熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願い します。</li> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste : <u>0.08</u> mm</li> </ul>			
<ul> <li>(5) Reflow heat stress, etc to switch may vary depending on reflow soldering chambers. Please verify it with the actual samples beforehand.</li> <li>リフロー槽の種類により、スイッチへのリフロー熱等、影響が異なる可能性がありますので、事前に十分確認の上使用してください。</li> <li>(6) The click feeling may be degraded after exposed to reflow heat for a long time. Reflow soldering should be performed in the shortest time and the lowest temperature.</li> <li>熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします。</li> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch.</li> <li>スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste : <u>0.08 mm</u></li> </ul>			たっては
<ul> <li>it with the actual samples beforehand.</li> <li>リフロー槽の種類により、スイッチへのリフロー熱等、影響が異なる可能性がありますので、事前に十分確認の上 使用してください。</li> <li>(6) The click feeling may be degraded after exposed to reflow heat for a long time. Reflow soldering should be performed in the shortest time and the lowest temperature.</li> <li>熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願い します。</li> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste : <u>0.08 mm</u></li> </ul>			
<ul> <li>リフロー槽の種類により、スイッチへのリフロー熱等、影響が異なる可能性がありますので、事前に十分確認の上 使用してください。</li> <li>(6) The click feeling may be degraded after exposed to reflow heat for a long time. Reflow soldering should be performed in the shortest time and the lowest temperature.</li> <li>熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願い します。</li> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste : <u>0.08 mm</u></li> </ul>			
<ul> <li>(6) The click feeling may be degraded after exposed to reflow heat for a long time. Reflow soldering should be performed in the shortest time and the lowest temperature.</li> <li>熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします。</li> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch.</li> <li>スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste : <u>0.08 mm</u></li> </ul>		-	十分確認の上
<ul> <li>should be performed in the shortest time and the lowest temperature.</li> <li>熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします。</li> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch.</li> <li>スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste: <u>0.08 mm</u></li> </ul>		使用してください。	
<ul> <li>熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします。</li> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste : <u>0.08 mm</u></li> </ul>		(6) The click feeling may be degraded after exposed to reflow heat for a long time. Reflow soldering	
します。 (7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。 (8) The thickness of solder paste: <u>0.08 mm</u>			
<ul> <li>(7) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its top and bottom side of switch.</li> <li>スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。</li> <li>(8) The thickness of solder paste: <u>0.08 mm</u></li> </ul>			うにお願い
スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにしてください。 (8) The thickness of solder paste: <u>0.08</u> mm			
(8) The thickness of solder paste : <u>0.08 mm</u>			
クリーム半田印刷厚: <u>0.08</u> mm			
		クリーム半田印刷厚: <u>0.08</u> mm	

ALPSALPINE CO., LTD.

DOCUMENT No.	
KSN-736	

8/14

PAGE

製品仕様書 (参考)

【Precaution in use】ご使用上の注意

TITLE

When using the product, please observe the following precautions. Also, make sure you observe all of the precautions listed in this specification. We are not responsible for any damages caused by use of the products which deviate from the absolute maximum rating and/or precautions, and so on. Regarding special specifications and test conditions which are not specified in this specification or the delivery specification, it is necessary to confirm whether warranty regulation is possible for each our product part number. So. please consult with us in advance or confirm if there are no problems in your applications under the condition of actual usage.

本製品のご使用に際しては以下使用上の注意事項を遵守願います。また、本仕様書に記載されているすべての注意事項や説明を注意深くお読みください。 本仕様書規定の絶対最大定格や使用上の注意事項等を逸脱した本製品の使用あるいは、注意点を逸脱した本製品の使用に起因する損害に関して、弊社は その責を負いません。本仕様書や納入仕様書に規定のない特殊仕様やテスト条件については、弊社製品番号毎に保証規定が可能かどうかの確認が必要と なりますので、事前にご相談いただくか、実際にご使用される条件において、貴社セットにて問題の無いことをご確認願います。

For the export of products which are controlled items subject to foreign and domestic export laws and regulations, you must obtain approval and/or follow the formalities of such laws and regulations.

国内外の輸出関連法規により規制されている製品の輸出に際しては、同法規を遵守の上、必要な許可、手続き等をとってください。

Products must not be used for military and/or antisocial purposes such as terrorism, and shall not be supplied to any party intending to use the products for such purposes.

軍事用途又はテロ等の反社会活動目的では、当製品を一切使用しないでください。また、最終的にそれら用途・目的で使用されるおそれがある法人・団体・ 個人等へも当製品を一切供給しないでください。

Unless provided otherwise, the products have been designed and manufactured for application to equipment and devices which are sold to end-users in the market, such as AV (audio visual) equipment, home electric equipment, office and commercial electronic equipment, information and communication equipment or amusement equipment. The products are not intended for use in, and must not be used for, any application of nuclear equipment, driving control equipment for aerospace or any other unauthorized use. With the exception of the above mentioned banned applications, for applications involving high levels of safety and liability such as medical equipment, burglar alarm equipment, disaster prevention equipment and undersea equipment, please contact an Alps Alpine sales representative and/or evaluate the total system on the applicability. Also, implement a fail-safe design, protection circuit, redundant circuit, malfunction protection and/or fire protection into the complete system for safety and reliability of the total system.

当製品は、特に用途を指定していないかぎり、本来、AV、家電、事務機、情報機器、通信機器、アミューズメント機器等の一般電子機器用に設計、製造 されたものです。したがいまして、原子力制御機器、宇宙・航空機で運行にかかわる機器等の用途では一切使用しないでください。上記の使用禁止の 用途以外で、医療機器、防犯機器、防災機器、海底用機器等の高度の安全性・信頼性を必要とする機器でのご使用の際は、弊社営業担当迄ご相談 いただくか、またはセットでの十分な適合性の確認を行っていただいた上で、フェールセーフ設計、保護回路、冗長回路、誤動作防止設計、延焼対策設計等の セットでの安全対策設計を設けてください。

Before using products which were not specifically designed for use in automotive applications, please contact an Alps Alpine sales representative. 車載対応製品以外の製品を車載用にご使用される場合は、事前に弊社へご相談ください。

The specification will be invalid if we do not get an approval or no orders within one year after we issued specification. 本仕様書は、発行日より1年間以内に承認、又は発注が無い場合には無効とさせていただきます。

Please note that we may change dimensions or product characteristics which are not specified in our drawings or specifications due to our circumstances. 製品図や製品仕様書に規定されていない寸法や製品特性以外の仕様につきましては、当社の都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

TactSwitch <sup>™</sup> is trademark or registered trademark of Alps Alpine Co., Ltd. タクトスイッチ®はアルプスアルパイン株式会社の商標もしくは登録商標です。

## ALPSALPINE CO., LTD.

Confidential

D	OCUMENT No.	TITLE	PAGE
D	KSN-736	PRODUCT SPECIFICATIONS (For reference)	9/14
		製品仕様書(参考)	5/11
ALSo	fety precautions】 安全に関		
Al Sal	• •	ッ るっ 在志 and specifications prior to operating a product. If it is used beyond the specification range, such as kir	ds of loads
AI	-	g, switching life, environmental conditions, or another specifications, there is a risk of malfunction du	
		Also, concern about contact burnout due to generated abnormal heating.	
		maximum rating" is specified value of voltage /current which must not exceed even for a moment. It i	s included in a
		e and inrush as transient current. In addition, please use the products with over the minimum rating. D	
		and much as transferr current. In addition, please use the products with over the minimum rating. D	
	-	cause contact unstable and/or poor conductivity.	
	• •	and contact unstand under poor contact my. Rの上お使いください。絶対最大定格や負荷の種類、開閉寿命回数、環境条件などの仕様範囲を超	マティー
		作の発生や異常発熱による接点焼損の原因となります。	
		は瞬時であっても超えてはならない電圧/電流の規格値をいい、サージ等の過渡電圧やインラッシュ4	辛の過渡電流を
		ッチは最小定格で規定された電圧電流値以上でお使いください。最小定格とはスイッチ接点が安定	
		なの印加電圧/電流の値をいい、これを下回る負荷条件で使用されると接触不安定や導通不良の原	
A2	Please check the circuit	diagram carefully and connect the terminals correctly. If the connection is wrong, there is a risk of the	switch
	malfunction or short circ	uit.	
	端子の接続は回路図を	十分にご確認いただき、適切に接続してください。誤った接続をされますと、誤動作やショートによる	焼損の危険が
	あります。		
A3	Do not keep turn on the	power during the switch installation and removal for electric wiring. There is a risk of electric shock o	r burnout
	by short circuit.		
	•	)外しや配線作業時は、通電したまま作業を行わないでください。感電やショートによる焼損の危険な	ŝ
	あります。		
A4	-	high level of safety applications, please consider to connect a protection circuit or a redundant circuit	for
	enhanced safety.		
	局い安全性が求められ	る機器にお使いになるときは、保護回路や冗長回路を設けるなど、機器の安全性向上を図ってくだる	Z()°
A5	The switch durability pe	rformance is changed significantly by electrical load conditions both voltage or current values, operati	on speed and
	environmental condition	s. Please be sure to perform operation in actual usage condition and use it after quality verification with	hin proper
	cycles. If the products ar	e continued to use in deterioration conditions, there is a risk of malfunction and/or burn out by abnorn	hal heat
	generation.		
	スイッチの耐久性は負荷	fの電圧・電流条件や、操作速度、使用環境等により大きく変化します。 実使用状態にて実機確認を	行い、性能上
	問題のない回数内で使	用してください。性能の低下した状態で使用を継続した場合、誤動作や異常発熱による焼損の危険	があります。
A6	Plastic resin used in this	product is "UL 94HB" flammability grade, Since it is slow burning grade, please pay attention to the	pread of
	fire by proper designing		
	本製品に使用している構	射脂はUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しているため類焼のリスクがあります。類焼	のリスクに留意した
	設計をしてください。		
A7	Do not attempt to disass	emble, repair or alter the products. Also, do not use a dropped products. There is a risk of the switch p	erformance
/	degradation, electric sho		
	÷	とない bulliou. 女造して使用しないでください。また、落下させた製品は使用しないでください。性能の低下や感電、	焼損の原因と
	なります。		加良のが固て
	· & / & / 0		
A8	Do not use the switches	in atmospheres of flammable gas, explosive gas and so on. There is a risk of thermal ignition or explosite	sion even
	small spark by the switch	n operation.	
	引火性ガス、爆発性ガス	などの雰囲気中でスイッチを使用しないでください。スイッチの開閉に伴う火花や発熱により発火又	は爆発を
	引き起こす原因となりま	す。	
A9	Under actual usage cond	itions, there is a risk that unexpected accidents may occur. So, please confirm safety by actual usage c	onditions.
	•	ては、不測の事故が発生する可能性があります。実際の使用条件にて安全性の確認を行ってくださ	
			• • •



DC	CUMENT No.	TITLE	PAGE
-	KSN-736	PRODUCT SPECIFICATIONS (For reference)	11/14
		製品仕様書(参考)	
C[Me	chanism design】機構設計		
C1	temperature, humidity an depression, please select 操作部を常時押し込んた 復帰性能が著しく低下す	・ long term depressed the plunger as usual. There is a risk of the plunger returning failure due to impact d adhesion of oils, greases, various solvents and so on. Do not design that normal use state keeps the pl proper circuit type of the switches. (normally open, normally closed). ごままの状態で長期使用しないでください。周囲温湿度の影響やオイルやグリース、各種溶剤等の付 -る恐れがあります。通常のご使用状態が操作部を押し込んだままにならないよう、組み込み機構に合 -マルクローズ)をご選択ください。	unger 着により、スイッチの
C2	purpose, please use our d	作を介してスイッチを押す構造にてご使用ください。メカ的な検出機能へのご使用は避けてください。	
C3	11.2	o flexure PWB. It may cause of the switch broken. への設置はお避けください。スイッチ破壊の原因となります。	
C4	e	e the switch in applications out of agreement terms and conditions, please contact us. しわれ方が、事前に合意した使用条件から変更される場合は当社に御連絡ください。	
C5	• • •	and parts layout shall be considered because the switch characteristics may change due to warp of PW が変化する場合がありますので、パターン設計・レイアウトについては十分考慮願います。	В.
C6	made with us.	B mounting hole and/or PWB footprints from our recommended dimensions, the prior consultation sha およびパターンに関し、推奨寸法以外を採用する場合は、当社に連絡願います。	ll be
С7	In case that the side of ste	to the side of rubber stem during usage and/or any process including reflow process. em is exposed to any force, this may cause switch breakage. sめ横方向から押す様な使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチ External forfe 外力 Stem ステム 「Stem ステム」 「Stem ステム」	テが破壊される場合があります。
C8	Switch shall not be kept p スイッチを長時間ONさせ	pressed for a long time. たる使い方はしないでください。	
С9	they shall verify such sui responsibility. The prior	ed for keeping pressed down for a certain duration of time. If users intend to use our switch for such pu tability with the own actual samples in advance as well as shall use for this purpose under their sole consultation with us is also needed. 金で設計されたものではありません。本製品を長押し使用される場合は当社にご連絡頂き、仕様内容	
C10	be degraded by off-center Hinge construction may of ステムのセンターを押す 感触が変化する場合があ	be pushed by actuator. Click feeling of switch may r push including stem edge due to hinge construction and/or tolerance stack-up at module level. cause slant angle push, causing switch to fail to make ON. 様にして下さい。ヒンジ構造及びセット上の累積公差によるセンターズレなどステムを端押しする状態 あります。 下時ステム押し位置が移動しますので,動作せずになる可能性があります。	では

DC	DOCUMENT No. TITLE PAGE		
	KSN-736	PRODUCT SPECIFICATIONS (For reference)	12/14
		製品仕様書 (参考)	
C11	Also, the recommended n	先端形状 is recommended to be φ4.0 mm flat design (refer to the right figure). naterial of actuator is ABS or PC resign. ジット形状を推奨致します。尚、材質はABSまたはPC等の樹脂を推奨致します。	Flat part 先端平坦部
C12	The maximum push angle 打鍵部の傾斜は、1度以	e of actuator shall be within 1 <sup>°</sup> . 内に設定して下さい。	Φ4.0 mm flat
C13		e specification is applied to switch (refer to Item 7.4, the strength of stopper). The switch may be broke しの荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。 スイッチに規定荷重以上の力が加わらない 一強度参照)	
C14		o the module casing surface. Otherwise, switch may be exposed to impact force, causing breakage of s 蜜体から出るようなご使用方法はお避け下さい。スイッチに衝撃荷重が加わりスイッチ破壊の原因とな	
C15	cause damage or breakage	pressed and/or operated at any impact force. When switch is pressed at impact force, this may potential e of switch. 与えないで下さい。衝撃が加わりますとスイッチが破損する危険性があります。	lly
D <b>ľ</b> Usa	age environment】 使用環境	i.	
D1	Electrical, mechanical, lif property.When continuou performance, so it will be 電気的性能、機械的性能	fe and environmental performance are not guaranteed as combination test conditions but defined indiv as operation is performed close to upper or lower limit temperature, there may be some impacts to the se especified sequential test on the specification individually. 能、耐久性能および耐候性の各性能は、単独試験における性能であり、各試験条件の複合条件を伊 囲の上限又は下限付近において連続動作を行う場合には、各性能値への影響が想定されますので	switch 呆証するものでは
D2	it may have the switch pe	ot-spring area where has high concentration sulfide gas, and/or in the place of exposed exhaust gas usu erformance degradation, so please be careful with external circumstance. 使用や自動車等の排気ガスに常時さらされる環境で使用される場合には、本製品の性能に影響を近 た十分ご注意ください。	
D3	please be careful to use it	ないため、使用環境によっては塵埃が内部に侵入し、接点障害を起こす場合があります。ご使用の間	際は塵埃が
D4	adhesive agents, packing contact surfaces may corr 硫化ガスや酸化ガスが発	ch are generated sulfide gas, or oxidization gas. Such suspected parts are molded parts, rubber material materials, mechanical actuators and lubricants. Please do not use those parts in a same application. Be rode and increase contact resistance. 巻生する成形部品、ゴム材料、接着剤、梱包材、機構駆動部、潤滑剤等を同一セット機器内で使用し 食し接触抵抗が増加する可能性があります。	ecause
D5	It may cause reduced life	on to design, generated gases from adhesives, paints, and resin materials does not stay around the prod cycles, failure, or malfunction. いから発生するガス類が本製品周辺に滞留しない構造にしてください。寿命低下や故障、誤動作の,	
D6	-	n high humidity and/or dew condensation conditions. It may cause current leakage. 層する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本製品はご使	用に

	CUMENT No. KSN-736	TITLE	PAGE
		PRODUCT SPECIFICATIONS (For reference)	13/14
		製品仕様書(参考)	
	lubricants, and organic 接点障害やスイッチ破	Lact failure or the switch malfunction, when using such as adhesives, screw lock liquids, greases, consolvents and so on, please check if materials intrude into the switch or some impact to the switch per key の原因になる可能性がありますので、接着剤、ねじロック剤、グリス、コーティング剤、潤滑剤、有品内部への染み込みや発生するガスによる性能への影響が無いことをご確認ください。	erformance.
E <b>[</b> Hand	ling for assembly】 組立	時の取り扱い	
	-	erminals, please pay attention to following items. には以下の点にご注意ください。	
	products, it may cause r はんだ付けの際、製品	heat to the products, the soldering should be performed within the specified conditions. If excessive attle, deformation and electrical characteristic deterioration. に過大な熱が加わらないよう規定条件内でのはんだ付け作業をお願いします。製品に過大な熱だ	
		he terminals when soldering. It may cause rattle, deformation and electrical characteristic deteriorat 際に、端子に荷重が加わらないようにご注意ください。ガタ、変形及び電気的特性劣化する可能	
	into the switch inside by 水溶性フラックスは製品	e flux for soldering. It may cause corrode the products. In addition, please control flux amount to a y excessive application. 品を腐食させるおそれがありますので、ご使用にならないでください。また、フラックスの過剰塗布に 見合が発生しないよう、塗布量の管理をお願いします。	
		do not cleaning the switch body by any solvents for whatever reason. でスイッチを洗浄しないでください。	
	soldering conditions in スルーホールのプリント	nole PWB, If thickness is thinner than recommendation, impact of heat stress will be increased. So, advance carefully. -基板及び推奨板厚より薄い基板をご使用される場合は、推奨基板よりも熱ストレスの影響が大き・ こ十分な確認をしてください。	•
		dition shall be verified by actual production condition. Eについては、実際の量産条件で確認されるようお願いします。	
	heat is applied constant	ould be performed within recommendation conditions, otherwise the click feeling may be degraded ly for a long time. ク感が低下する可能性がありますので、推奨リフロー条件内でリフローを行う様にお願いします。	l when the reflow
	When PWB is split in-p deformation.	rocess after soldering, please be careful not to apply a load to the switch because there is a risk of the	he switch
	半田付け後にプリント基	も板の割り工程を行う場合は、スイッチが変形するおそれがある為、スイッチに荷重が加わらない」	らにご注意願います。
	soldering due to thickne	ng to shape of pattern or resist around the switch mounting area on PWB, it may have some influen ess. るプリント基板のパターンやレジストの形状により、その厚み分が半田付け性に影響する場合があ	
	No clearance between the	he bottom of switch and PWB surface. 反との間に隙間が生じないように取り付けてください。	

DOCUMENT No.		TITLE	PAGE	
	KSN-736	PRODUCT SPECIFICATIONS (For reference)	14/14	
		製品仕様書(参考)		
E2	When ultrasonic welding is performed in manufacturing process of the applications, there is a possibility of performance deterioration. So, please confirm the switch performances after welding. Depend on relation between the vibration direction, frequency, and the switch layout, there is a possibility of performance deterioration or broken by generated resonance phenomenon. If such issues happened, please consider to change the welding condition, direction of vibration and component layout accordingly. 製品組み込みユニットの製造工程で超音波溶着を実施される場合は、スイッチに不具合や性能低下が生じる可能性があります。溶着後に スイッチ性能に問題が生じていないかご確認をお願いします。超音波溶着時の振動方向や振動数とスイッチのレイアウトの関係次第では、 共振現象によりスイッチの性能劣化や損傷が発生する場合がありますので、問題が生じた場合には溶着条件や振動方向、部品レイアウトの 変更をご検討願います。			
E3	When the unfinished units as a mounting PWB are stacked or transported in your process, please do not apply any force to the operation part. It may damage and broken. In addition, please do not hold the operation part with load applied. It may cause deterioration of returning force or deformation of the components. 実装した基板などの組立途中部品の積み重ねや搬送などの取り扱い時に、操作部に力が加わらないようご注意ください。操作部が破損する可能性があります。また、操作部を押し切るなど荷重をかけたままでの保存はしないでください。スイッチ復帰力低下や部品変形の原因となります。			
E4	The rubber stem have swelling property depend on compatibility of oil, chemicals and so on. It may cause come-out or broken issues. When the grease is applied to the cams, please note that do not adhere to the rubber stem. Also, should be considered impact of adhesion by actual used oil and chemicals. Organic solvents as toluene and cyanoacrylate adhesives are especially affected, so please do not use them in the units or applications. ラバーステムは、油・薬品等が付着すると膨潤する性質があり、脱落や破れの原因となる恐れがあります。カムにグリースを塗布する場合は ラバーステムに付着しないよう注意頂くと共に、付着時の影響につきましても、実際に使用する油・薬品での影響のご確認をお願いします。 トルエン等の有機溶剤やシアノアクリラート系の接着剤については特に影響を受けますので同一セット内およびその近傍では使用しないで ください。			
E5		nical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 乳等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。		
E6	After reflow treatment of this switch, this switch is not allowed for wave/flow soldering at the backside of PWB. Due to jet stream, flux may penetrate into inside of switch. 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田しないで下さい。フラックス吹き上げによりスイッチにフラックスが侵入 する場合があります。			
E7		essive load is not applied to the switch due to the contact between the board and the switch during m マチが接触する事により、過度の荷重がスイッチに加わる事が無いように実装をお願いします。	ounting.	
E Ist	orage】保管方法			
F <b>1</b> St	The products should be u in room temp and normal the box by a plastic bag a 製品は、納入時の包装状	sed as soon as possible within 6 months after delivery. It should be stored in our original packaging a humid condition to avoid sunlight and corroded gas circumstance. After opening the package, pleas gain, and should be stored it in same environmental condition as above. 大態のまま常温、常湿で直射日光が当たらず、腐食性ガスが発生しない場所に保管いただき、納力 ご使用ください。梱包の開封後は、ポリ袋で再度製品を密封し外気との遮断を図り、上記と同様の	e seal へから6ヶ月以内を	
F2	of the packing boxes.	The products should be stored in our original packaging condition. Please do not apply overstock stress since it may cause deformation of the packing boxes. 梱包箱が変形する様な過剰な積み重ね等による応力を避けて弊社出荷時の梱包状態のままで保管してください。		
F3	Keyswitches shall be kept as released position, when they are stored. スイッチの操作部を押し切ったままでの保存はしないでください。			
1				